

# 備戰行動支付 華美電子搶佔先機

文：馬蘭娟

蘋果公司於2014年10月發佈基於NFC技術的Apple Pay產品，帶給消費者便捷安全的行動支付體驗，也同時激發了相關業者的參與熱情。

由於Apple Pay只需在終端讀取器上輕輕一“靠”無需接觸，就可以完成整個支付過程。這使得三分之二的Apple Pay新用戶在2014年11月份多次使用這項服務，用戶平均每週使用Apple Pay 1.4次。

根據市調研究調查機構ABI Research預測，在2017年搭配NFC的裝置出貨量將達19.5億台，同年的消費性電子產品出貨量也將上看3.95億台，預見屆時大部份消費性裝置都將搭載NFC功能。而研究機構IHS於2014年發佈的報告則顯示，2014年的NFC智慧手機出貨成長率高達50%，且截至2018年底，搭配NFC的手機出貨量將較2013年成長325%；屆時，64%的智慧型手機都將配備NFC技術，可見行動支付的光明前景。

不久前由NXP發起的「臺灣行動智慧裝置使用行為調查報告」顯示，臺灣地區消費者多數人對使用NFC進行行動支付與資料分享及交換抱有高度興趣：八成具NFC經驗受訪者願意使用NFC進行更多元的行動支付，其中iOS使用者相較於Android使用者更有意願使用NFC付款。

相比其他的行動支付方式，Apple Pay的主動架構更加安全可靠。Apple Pay讓使用者先採取空中開卡，日後只要開啟App與密碼驗證等簡易步驟就可輕鬆完成線上或線下付款。且在交易過程中，商家僅可取得經由卡片資訊(PAN)轉化而成的虛擬數位憑證(Token)，不僅可有效避免個資洩露，更可消除偽卡風險，解決NFC行動支付的安全性問

題。相較於以往的被動模式(Passive Mode)，Apple Pay的主動模式(Active Mode)已成為Visa及Master認定的標準；同時為與世界相關信用卡組織接軌，預期中國銀聯也將在未來改採主動模式。

華美電子近日宣佈針對行動支付推出功率放大晶片Booster PA AB988。利用此一元件，即可將不具訊號發射能力的安全晶片(SE)進行功率放大，再透過內建天線將13.56MHz射頻發射至讀卡機，形成同ApplePay的主動模式架構，輕鬆完成行動支付，勢將掀起另一波NFC行動支付的熱潮。

華美電子董事長楊名衡表示：「檢視Apple Pay的硬體架構，其關鍵元件包含了NFC、SE晶片、Booster PA與天線；藉由此三者環環相扣，才能形成所謂的主動模式架構。然而其中供應最受限制的莫過於Booster PA。此次華美電子經多年研發、突破重重挑戰推出的Booster PA AB988，正可填補市場缺口。」

此外，華美電子的功率放大晶片Booster PA AB988也可與自行研發的2D天線，及安全晶片整合成一統包式解決方案(turnkey solution)。未來智慧型手機廠商只需將華美電子的統包式行動支付方案直接設計在手機主機板中，就可輕鬆提供同Apple Pay的行動支付功能。

楊名衡進一步指出，華美電子的Booster PA AB988可與各種安全晶片整合，其中也包含中國市場的國密晶片。因此，對於行動設備製造商而言，將可在華美電子的協助下加速發展出可與Apple Pay比擬的行動支付服務功能，搶佔海內外市場的先機。CTA